

导热硅脂 T-4303

1、用途：

固加导热硅脂主要用于填充功率元器件和散热器的装配面，帮助消除接触的空气间隙，可增加热流通道，减少电阻，以便降低电子元器件的温度，提高其可靠性和使用寿命。也可用于电脑 CPU 风扇与散热片之间的热传导。

2、性能：

本产品是用具有良好的导热、绝缘性能的填料与有机硅脂混合而成的白色膏状物，在长时间 200℃，甚至 200℃以上的高温露置也不干、不硬、不溶化，且无味、无臭，对铁、铜、铝等金属均无腐蚀作用；具有优异的电气性能，绝缘、防潮、防震、耐辐射老化等，并能加快电子、电器至散热装置的热传导速度，从而提高散热效率。

3、技术指标：

中文名称	导热硅脂（散热膏）
型 号	T-4303
外 观	乳白色膏状物
针入度（25℃，1/10mm）	200~250
挥发份（%，200℃，24h）	≤3.0
油离度（%，200℃，24h）	≤1.5
体积电阻（Ω·cm）	≥1×10 ¹⁴
介电常数（1 MHz）	4.0~6.0
介电损耗（1 MHz）	≤9×10 ⁻³
击穿电压（kV/mm）	≥5.0
导热率 [W/（m·K）]	≥0.7
工作温度（℃）	-60~200
腐蚀试验	合格
垂流试验	合格

注：K—开尔文（温度单位）

4、包装、贮存及运输：

- ①1kg/罐、25kg/桶；
- ②产品密闭贮存于室温通风阴凉处，保质期一年；
- ③本产品为无溶剂产品，按非危险品贮运。